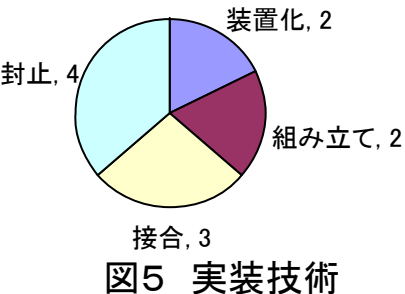
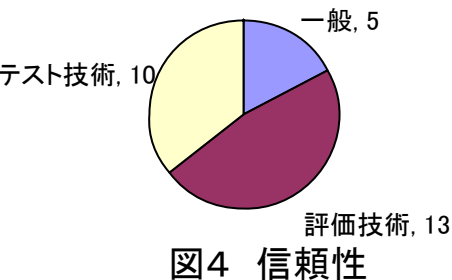
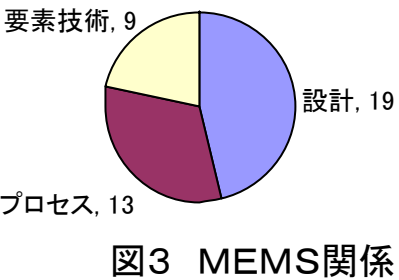
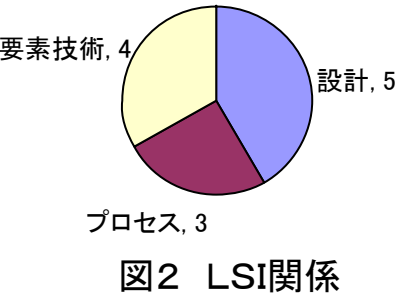
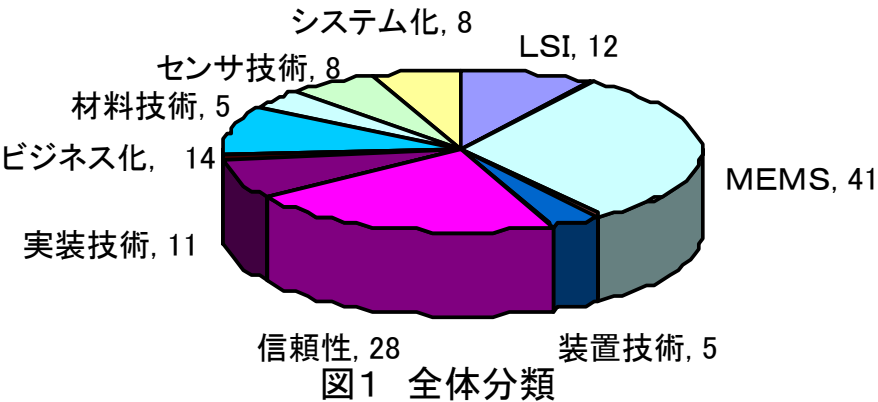


第1回集積化MEMS研究会 アンケート結果

研究会での発表内容に対する要望項目

1. 今後の研究会の発表内容について具体的な要望があれば記入願います。
上記質問事項に下記のアンケート結果(図1から図5参照)を得る。
- ☆関心の順番は、MEMS、信頼性、ビジネス化、LSI、実装。
 - ☆ビジネス化に関心が高いことは、単なる研究から実用化への意識の高まり?を意味している。
 - ☆アンケートのとり方にも問題があったと考える。要素技術という漠然としたキーワードではなくもっと細かい分類が必要だったと反省。MEMS設計に関心が高かったが、これも設計の何?というのが残る。



研究会の運営に望むこと(1)

2-1 招待講演として希望者がありますか？→ ()の講演を聴きたい

☆下記 4件の回答のみ、希望が少なく意外な結果であった。

東北大 江刺先生、東大 日暮先生、九大 澤田先生、TI DMD開発者

2-2 ポスター講演も併設。→ 希望(する しない)

☆下記回答により、研究会でポスターを実施することは問題ないと判断できる。むしろ、希望者が多いと判断。

希望する 22件 希望しない 4件 無回答 6件

2-3 開催地設定において見学のプログラムを併用した内容の可否 (可、不可)

☆下記回答により見学をプログラムに入れることは価値があると判断できる。

可 30件 無回答 2件(ただし、本2件ともに希望施設に回答済)

2-3-3 もし見学を併用とした場合、見学として下記の施設が挙げられますが、下記以外でご興味ある施設はありますか？ また、下記設備で特にご興味がある設備があれば○をつけて下さい。(複数可)

☆本集計結果については、公開を控えさせていただきます。

研究会の運営に望むこと(2)

2-4 討論の場 → 有無（有、無）

☆下記回答により討論をプログラムに入れることは価値があると判断できる。

有 24件 無 1件 無回答 9件（ただし、9件中2件に希望内容有）

2-4-1 有とした場合 どのようなことを討論してほしいですか具体的な内容の記入をお願いします

☆下記に提案された具体的な内容を項目として分類した結果を図7に示す。将来を見据えた議論のテーマ（デバイスの動向、統合等）が多く提案されていた。ビジネス化に向けての展望や取り組み方（研究開発費確保）への解を求めていると考えられる。本音の議論も期待されていた。

2-5 Webによる掲載についてどのような掲載を希望しますか？ 具体的な要望があれば記入願います。

☆図8に希望内容の分類を示す。広報でこのデータの下に運営に反映していきたい。パスワードをどうするか議論は残る。賛助会員のHPへのリンクなどは重要なことと考える。

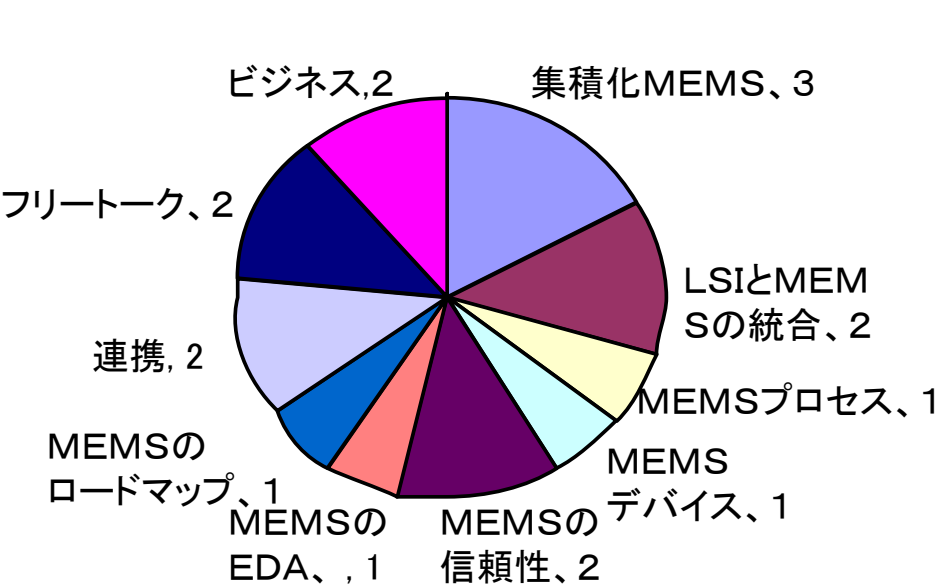


図7 討論内容分類

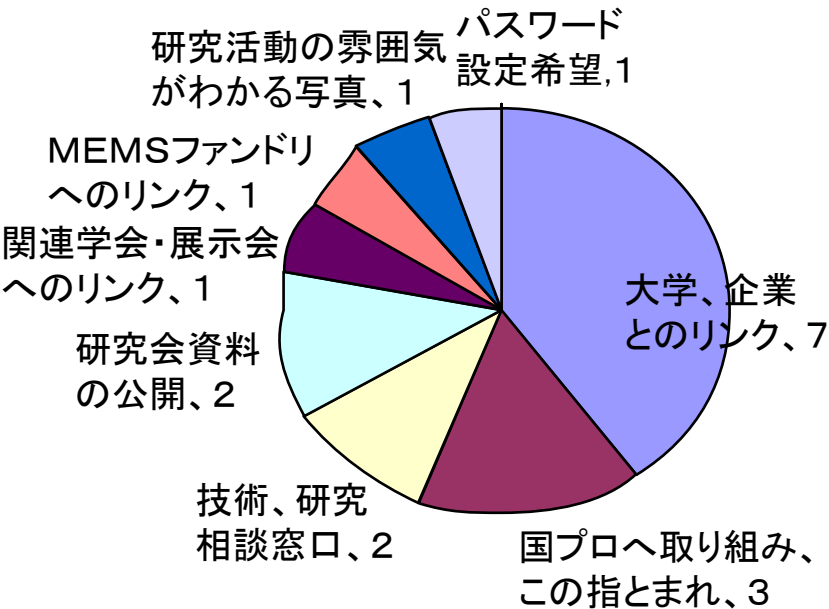


図8 Webへの希望内容分類

共催学会及びシンポジウムについて

3. 共催研究会、学会について希望する共催研究会等があれば記入願います。

☆図8に分類結果を示す。信学会、電気学会、実装学会との共催希望有。今後の参考とする。化学系、材料系、機械系との共催もあると考えるがアンケートのとり方にも問題があったかも知れない。

4. 応物シンポジウムを来春シンポジウムを企画します。企画するに当たり、希望するテーマがありましたら記入願います。

☆表2に提案テーマを示す。今年の春がテーマとして総論であったことも考えると次回のテーマは各論として表2の3項目は参考になるかもしれない。チュートリアルなものは講座？のようなもので研究会が別に企画するのもかもしれない。

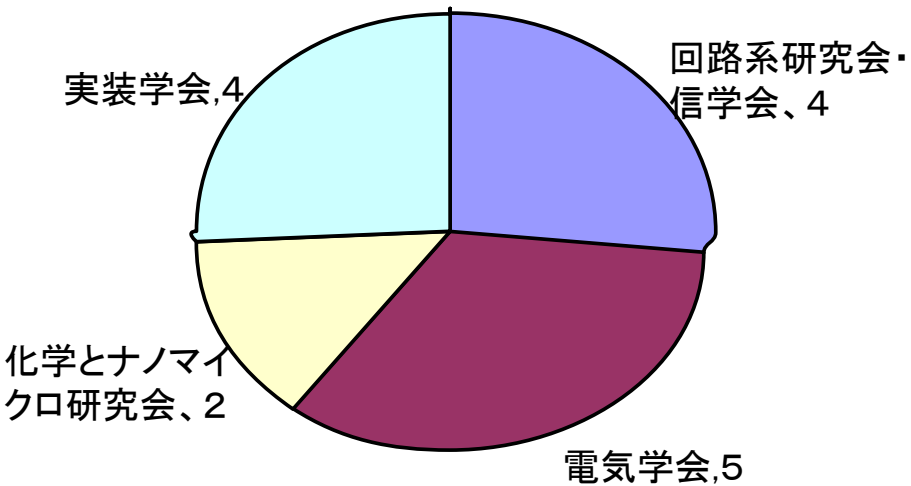


図8 共催学会分類

・光MEMSの現状と将来	1
・MEMSの評価技術	1
・CMOSとMEMSの集積化のためのプロセス技術	1
・素人向けのチュートリアル	1
・MEMSプロセス、評価等の要素技術	1

表2 シンポジウム提案事項

今回の研究会の感想

7. 今回の研究会の感想について記載をお願いします。

☆図10に感想の分類結果を示す。参加者からは好意的な感想を頂いたと考える。各感想については、委員会できちんと議論する題材と考える。今後の研究会に十分反映していきたい。

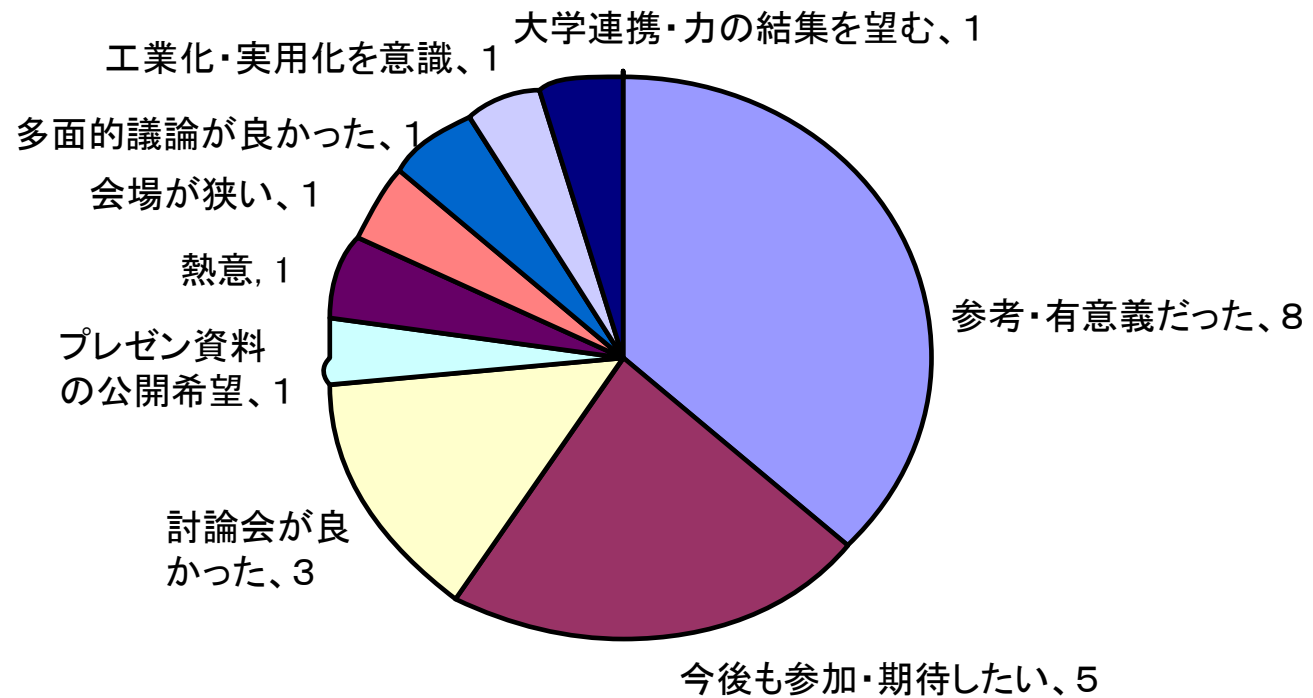


図10 感想の分類結果

まとめ

- ★ アンケート項目の準備不足のために項目に不備が目立った。これは今後のことも踏まえ反省。
- ★ アンケートにより、討論会、見学の実施は好意的に受け入れられたと考える。ポスターの実施も可能であれば今後実施。
- ★ ビジネス化、連携に向けて本研究会が起点になればと考える。枠組みの宿題。
- ★ HPの充実。
- ★ 研究会の資料の公開要。
- ★ 他の研究機関との共催については、枠組みも含めて議論要。
- ★ 次回シンポジウムは「集積化MEMSに向けた要素技術」が一つのテーマか？
- ★ 今回キーワードであげていなかった項目を以下に列挙する。次回の宿題。
 - 1) MEMSの分類 → RFMEMS、PowerMEMS、BioMEMS、センサMEMS
光MEMS
 - 2) CAD → 設計環境、設計レベル、設計統合
 - 3) ビジネス → 市場、コスト、ベンチャー
 - 4) 知財関係 → 特許戦略、IP活用
 - 5) 信頼性 → 歩留まり、品質管理
 - 6) 標準化 → すべての項目に関連

この度はご協力感謝申し上げます。皆様のご意見を本研究会に反映していきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。